國立臺北科技大學自動化科技研究所 嵌入式工業機器視覺

Integration of Industrial Machine Vision in Embedded Systems

Assignment #2

Starts from Wednesday, 12/06 Due Wednesday, 12/20

- 1. 請依據 Lab 17 的內容實作量測應用,並完成以下工作:(50%)
 - 建立 Circle Measurement 應用程式(C#或 Python),分別基於輪廓點與次像素邊緣。(10%) (1)
 - 請說明在測試圖中,為何輪廓點所擬合的圓,會比次像素邊緣擬合的圓來得小。(5%) (2)
 - 在 Lab 17 中, 次像素的估測並沒有考慮到專利中 s 的調變函數, 請接續下去在程式中計算 $s' \circ (5\%)$
 - 在 Lab 17 中, 次像素的估測只計算出專利中 413 的位置, 請接續下去在程式中計算至 415 的 位置。(5%)
 - (5) 請說明並推導專利中,梯度最大值為何發生在 $s = \frac{G_+ G_-}{4G_0 2(G_+ + G_-)}$ 的位置。(10%)
 - 在測試圖中,有些圖形不是圓,但依然會被擬合導致錯誤的結果,請使用上課教過的圓周長 面積比,加入程式中進行篩選,避開非圓的邊緣點擬合;並請說明所使用的圓周長面積比門 檻值及使用原因。(5%)
 - 以 PyQt5 建立 Circle Measurement 應用程式。(10%)
- 2. 請依據 Lab 18 的內容實作字元辨識,並完成以下工作:(50%)
 - 請包裝 MLP 類別成為 C-style 函式庫。(25%)
 - 請參考 Lab 8~ Lab 11 應用 Ctypes 在 PyQt5 的介面下呼叫 MLP 函式庫,並執行字元辨識功能。 (20%)
 - 在執行 Lab 18 的 "OCR Jog" 時,發現字元偵測並非一定按照由左而右、由上而下的規則判斷, 請撰寫一個排序方式,讓訓練階段的匹配及後續辨識更合理。(5%)

請上傳 PDF 說明檔、函式庫 (DLL),以及有修改過的程式檔案 (.ui, .pv, .h, .cpp)